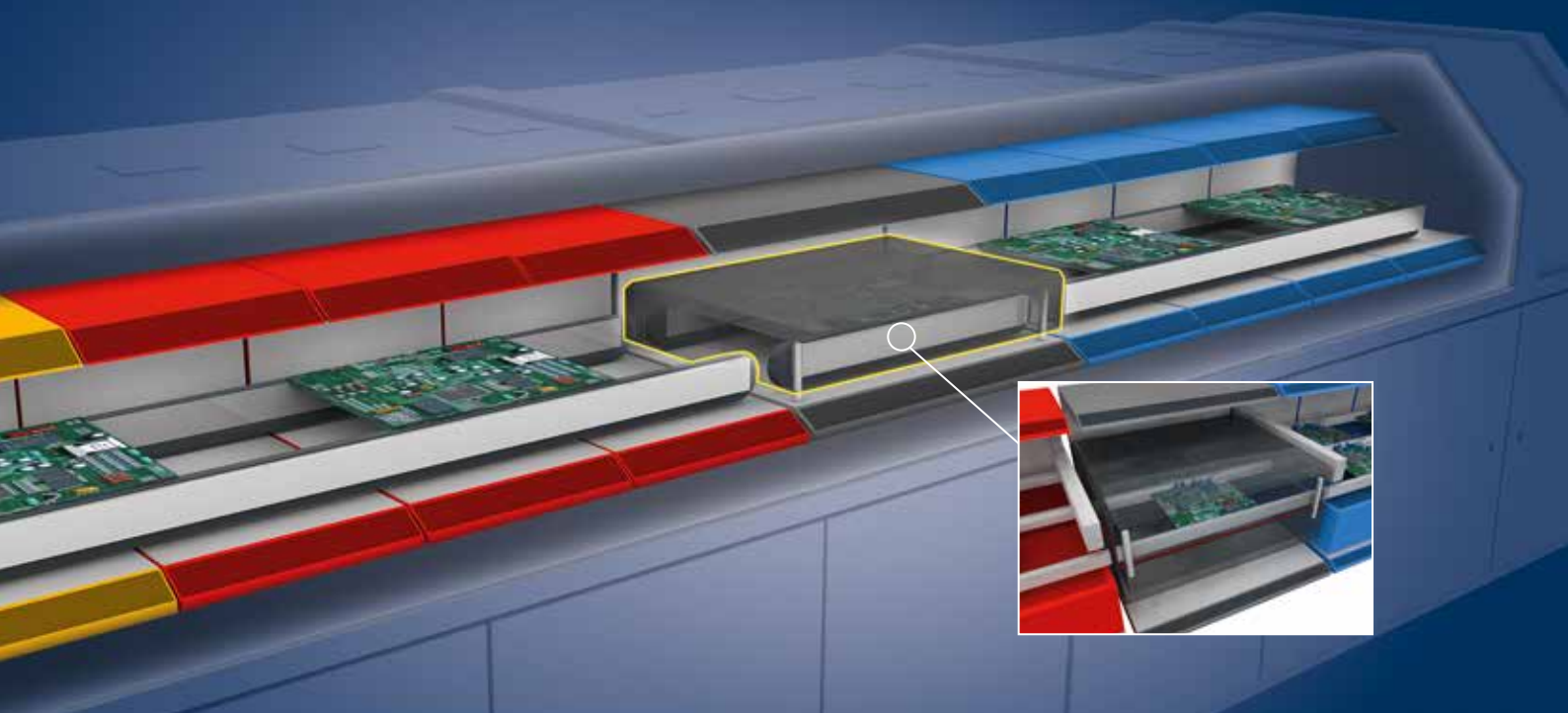


THERMAL SYSTEMS

Vakuum nach dem Lötprozess zur Reduzierung der Voids

Reflow Konvektionslötén mit Vakuum



KONVEKTIONSLOTEN
VisionXP+ Vac

Neu! Die 2 in 1 Lösung für das Reflowlöten mit und ohne Vakuum

Energieeffizient, wartungsarm und voidfrei – Wir bieten mit vielfältigen Optionen für die Anlage VisionXP+ innovative Lösungen für das Reflow-Löten. Eine neue Vakuum-Einheit ermöglicht nun Konvektions-Lötprozesse mit Unterdruck – in nur einem Prozess.

Die VisionXP+ mit Vakuumsystem entfernt bereits direkt nach dem Aufschmelzen des Lotes – während sich das Lot noch im optimalen schmelzflüssigen Zustand befindet – zuverlässig Poren und Ausgasungen.

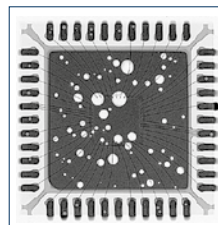
Mit einem Vakuumwert zwischen 100 mbar – 10 mbar sind Voidraten von unter 2 % realisierbar. Druckverlauf und Geschwindigkeit können individuell eingestellt und als Profilparameter abgesichert werden. Durch diese integrierte Lösung gelingt ein zeiteffizienter und stabiler Produktionsablauf.

Eine aufwendige Reparatur oder Verwurf der Baugruppe ist nicht mehr notwendig.

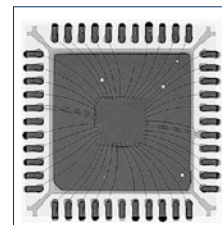
Voidraten unter **2 %** realisierbar



geöffnete Vakuumkammer



ohne Vakuum



mit Vakuum

- **Vakuum gemessen in der Prozesskammer und nicht an der Vakuumpumpe**
- **Vakuum bis zu 2 mbar zur Reduzierung der Voids in Lötstellen**
- **Dreigeteilter Transport: Vorheiz-/Peakbereich, Vakuummodul und Kühlstrecke**
- **Automatisches Auffahren der Prozesskammer in Prozess- oder Wartungsposition**
- **Geringer Wartungsaufwand durch integrierte Pyrolyse und separate Filterung der in der Vakuumkammer abgesaugten Atmosphäre**
- **Wenig Stillstandszeiten durch geringen Wartungsaufwand**
- **Hervorragende Kühlleistung, verlängerte Kühlzeit durch reduzierte Bandgeschwindigkeit**